

Kupfer DIN 1787

| Güte | Wst-Nr. | Dichte ca. | Legierungsbestandteile | Hinweise auf Eigenschaften und Verwendung |
|-------------------|---------|------------|---|---|
| E-Cu 57 (E-Cu) | 2.0060 | 8,9 | Cu ≥ 99,90 % Sauerstoff 0,005-0,040 % | Sauerstoffhaltiges Kupfer mit einer elektrischen Leitfähigkeit von mind. 57,0 m/Ω mm ² , jedoch ohne Anforderungen an Schweiß- und Hartlötbarkeit. |
| SF-Cu | 2.0090 | 8,9 | Cu ≥ 99,90 % P = 0,015-0,0404 | Ohne Anforderung an elektrische Leitfähigkeit jedoch mit sehr guter Schweiß- und Hartlötbarkeit sowie Wasserstoffbeständigkeit, Rohrleitungen, Apparatebau, Bauwesen. |
| SECu | 2.0090 | 8,9 | Cu ≥ 99,90 % P = 0,003 % | Hohe elektrische Leitfähigkeit mit hohen Anforderungen an Umformbarkeit. Gut schweiß- und hartlötbar. Für Elektronik, auch Plattierwerkstoff |

Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) DIN 17 663

| Güte | Wst-Nr. | Dichte ca. | Legierungsbestandteile | Hinweise auf Eigenschaften und Verwendung |
|-----------------------------|---------|------------|---|--|
| Cu Ni 12 Zn 24 (Ns 6512) | 2.0730 | 8,7 | Cu 63,0-66,0 % Ni 11,0-13,0 % Zn Rest | Gut kalt umformbar. Tiefziehteile, kunstgewerbliche Gegenstände, Bauwesen, Innenarchitektur, Federn. |
| Cu Ni 18 Zn 20 (Ns 6218) | 2.0740 | 8,7 | Cu 60,0-63,0 % Ni 17,0-19,0 % Zn Rest | Wie Cu Ni 12 Zn 24, jedoch anlaufbeständiger. Bevorzugt für Federn |

Weitere Legierungen auf Anfrage.